

**特点:**

- 低插入损耗: 典型插入损耗 0.6dB
- 优异的输入输出匹配: 驻波比典型值 1.5:1
- 高承受功率: 脉冲承受功率 300W
- SMT 封装
- 封装尺寸: 8.1\*5.1\*3.0mm(不含引脚)

**性能参数 (25°C):**

参数名称	符号	测试条件	参数值			单位	备注
			MIN	TYP	MAX		
频率范围	f	$Z_{in}=Z_{out}=50\Omega$	800		1500	MHz	
插入损耗	IL	$Z_{in}=Z_{out}=50\Omega$		0.6	0.8	dB	
输入驻波比	VSWR <sub>i</sub>	f=800~1500MHz		1.5:1	2.0:1		
输出驻波比	VSWR <sub>o</sub>	RF <sub>IN</sub> 输入功率-20dBm		1.5:1	2.0:1		
脉冲波承受功率	P <sub>PULSE</sub>				300	W	
峰值功率连续工作时间	t	Pulse width≤25μs; Duty cycle≤2.5%			5	Min	
限幅电平	P <sub>O</sub>	P <sub>PULSE</sub> =300W		+17	+21	dBm	
工作温度	T		-55		+85	°C	
质量	m				2	g	

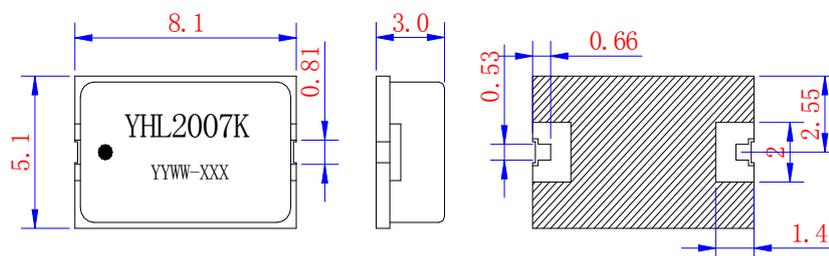
**极限参数表:**

参数名称	极限值
输入射频功率	300W
装配温度	+183°C, 20s
工作温度	-55~+85°C
贮存温度	-55~+125°C
静电防护等级(HBM)	Class 1A

超过以上条件, 可能引起器件永久损坏。

**封装外形图:**

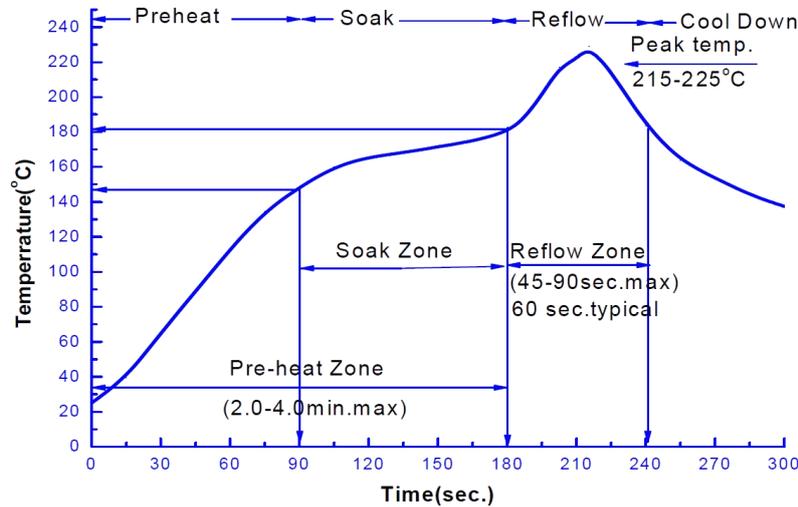
单位: mm 公差: ±0.2mm


**字符标志及引脚定义:**

字符	定义	字符	定义
YHL2007K	产品型号	●	射频输入端
YYWW	批次号	▨	接地
XXX	序列号		

### 产品使用注意事项:

- 1.产品属于静电敏感器件，产品在运输、装配使用过程中请注意静电防护；
- 2.产品使用时请保证接地良好（GND 引脚和底部金属化区域）；
- 3.产品推荐采用 SMT 工艺贴片使用，采用 Sn63/Pb37 锡膏，熔点 183℃回流焊接，回流温度推荐曲线。



此图为推荐回流温度曲线，因基板及回流焊设备性能不同而有所差异。请依据使用的基板与回流设备确认实际温度曲线，实测回流基板温度不得超过 230℃。

- 4.如特殊情况需采用手工焊接，烙铁温度 350℃，焊接时间不超过 3 秒；回流及手工焊接次数不大于 3 次。
5. 产品在存储时需采用防静电托盘或防静电袋进行密封包装，存放条件：温度 10~35℃，湿度 35~65%RH；对于需长期储存（超过半年）产品尽量在充氮干燥环境下存放。
6. 客户在产品应用时应结合实际环境考虑是否对产品进行防护处理。对有盐雾防腐等要求的环境，客户在对产品焊接及清洗完成后，应对产品进行三防喷涂处理，以提高产品耐环境适应性能力。